



## Soitec lance Smart Stacking™, un procédé unique d'empilement de circuits avec deux offres pour ses clients

*Cette offre est portée par la business unit Tracit créée suite à l'acquisition de la société éponyme en 2006. Elle permet aux industriels soit de confier à Soitec le collage de plaques déjà processées, soit de bénéficier d'un transfert de la technologie Smart Stacking™.*

**Bernin, le 15 mai 2009** — Le Groupe Soitec (Euronext Paris), premier fournisseur mondial de substrats innovants pour l'industrie micro-électronique, vient de mettre au point un procédé unique, Smart Stacking™, utilisé pour empiler des plaques contenant des circuits (**Communiqué du 26 mars 2009**). Ce procédé rend, à dimension donnée, les circuits plus performants et permet d'intégrer en même temps plusieurs fonctions différentes au produit, assurant ainsi un gain de place et de poids. Cette technologie innovante d'intégration tridimensionnelle de circuits enrichit l'offre de Soitec qui s'est développée autour du procédé Smart Cut™, véritable rupture technologique que le groupe a industrialisée pour produire entre autres le SOI.

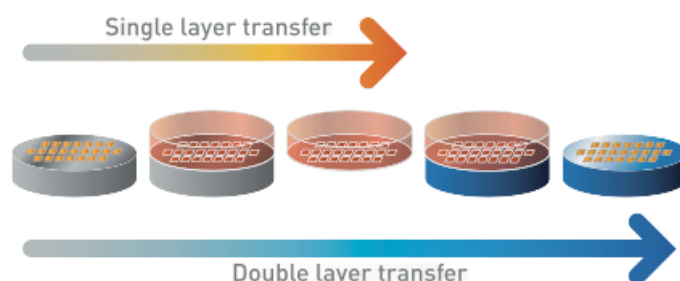
Smart Stacking™ peut d'ores et déjà être utilisé pour la production de circuits dans le domaine des capteurs d'image de haute performance. Ce procédé innovant sera bientôt exploité pour toute une gamme de nouvelles applications photoniques, de circuits RF et, à terme, d'architectures de produits 3D comme celles incluses dans les appareils photo numériques.

Le Groupe propose deux options à ses clients :

- Une prestation de services à valeur ajoutée où Soitec assure directement le collage de plaques par ses propres capacités de production, offre qui répond à des applications de moyen volume.
- Une offre de transfert industriel de son procédé *Smart Stacking™* où Soitec cède la licence de sa technologie. Elle permet aux clients ayant des applications à plus fort volume, de simplifier leur logistique et de réduire leur temps de cycle de production ainsi que leurs coûts.

« L'aboutissement du développement de la technologie Smart Stacking™ confirme l'intérêt stratégique de l'acquisition de Tracit ainsi que la stratégie générale de Soitec axée sur l'innovation, le développement de technologies de pointe, leur industrialisation et le transfert industriel aux fabricants de circuits », conclut Bernard Aspar, Directeur de la business unit Tracit.

Pour plus d'informations : <http://www.soitec.com/fr/actualites/communiques-de-presse-310.php>



1. Circuit layer transfer processes (Source: Soitec)



### **À propos du Groupe Soitec :**

Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l'industrie microélectronique de pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plate-forme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques.

Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant utilisées mondialement. Basé à Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux USA, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production à Singapour actuellement en phase de qualification.

Le groupe comporte deux autres divisions : Picogiga International aux Ulis et Tracit Technologies à Bernin. Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques épitaxiées de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. Les actions du groupe Soitec sont cotées sur Euronext Paris. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet [www.soitec.fr](http://www.soitec.fr)  
Soitec, Smart Cut et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies.

### **Contacts presse - H&B Communication**

Marie-Caroline Saro - Tél. 01 58 18 32 44 / 06 70 45 74 37 - [mc.saro@hbcommunication.fr](mailto:mc.saro@hbcommunication.fr)

Claire Flin – Tél. 01 58 18 32 53 / 06 82 92 94 47 – [c.flin@hbcommunication.fr](mailto:c.flin@hbcommunication.fr)